

2026 年 10 月 13 日

各 位

公 司 名 尼得科精密检测科技株式会社
代 表 人 总裁 山崎秀和
公司地址 京都府向日市 Nidec Park33 番地 C 栋

尼得科精密检测科技将参展 TPCA Show TAIPEI 2026

尼得科精密检测科技株式会社（以下简称“本公司”）将参展于 2026 年 10 月 20 日（星期二）至 10 月 22 日（星期四）在中国台北南港展览中心举办的国际展览会“TPCA Show TAIPEI 2026”。



本展示会由中国台湾电路板协会（TPCA）主办，汇集了用于电子、信息通信、控制设备等的电子电路和实装技术，以及电子基板的原材料和化学品等，与 PCB（印制电路板）行业相关的所有产品和技术。

本公司以“**支撑 AI 时代品质的创新检测技术**”为主题，针对随着微细化与 Heterogeneous Integration（异构集成）而不断大型化、高密度化的高端电路基板，为确保持续进化的电子产业需求，提供优化的解决方案。

此外，我们将实物展示面向背钻的 X 射线检测解决方案，以及通过尼得科集团的协同效应新诞生的自动搬运机“EFEM（Equipment Front End Module）”。现有的图像检测装置和电气检测装置也实现了更高精度，我们将提出满足前沿产品质量要求的综合检测解决方案。

〈参展概要〉

- ・会期：2026 年 10 月 20 日（星期二）～10 月 22 日（星期四）
- ・会场：中国台湾台北南港展览中心（TaiNEX 1）
- ・展位：K-725
- ・官方网站：<https://www.tpcashow.com/>

〈主要展示内容〉

- ・面向 FOPLP/RDL 的导通/短路检测装置“GATS® - 7885”

- 半导体封装多面贴装全面板基板检测装置 “GATS® - 8370”
- 面向大型分立半导体封装的高精度检测装置 “GATS® - 7837”
- 面向大型/多引脚基板的导通绝缘检测装置 “STAR REC®V6”
- 支持 CoWoP 面向大型 HDI 的导通/短路检测装置 “GATS® - 8360”
- 支持高密度基板的 2D/3D 光学式检测装置 “RSH 系列”
- 光模块·大型基板对应次世代 AI 外观检测装置 “AURCA Series”
- 面向 TGV (Through Glass Via) 的高精度检测解决方案
- 窄间距对应治具解决方案 “NS 探针”

(实机展示)

- 用于背钻的高速 CT 型 X 射线检测机
- Wafer 用自动搬送机 EFEM “AVR SMV 3000” ※与尼得科仪器共同开发